

SID

Werk: Rot am See

Artikel:

ML6

Erstellt:

Wodke, Alexander

Kunde:

Datum:

06.09.2022



Prozesstechnik: B: Pinlamination C: Pinlamination

Materialtext	Mat. Nr.	µm	Aufbau	Prozessaufbau
A-RS Kupferfolie-009my 330x490mm	50201012	9	VS	1
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF	50200641	60		2
A-RS Kupferfolie-009my 330x490mm	50201012	35	L2	3
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF	50200641	125		4
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF	50200641	0		5
A-RS-FR4-ML-0.20mm-035+035-TG150-HF	50200653	33	L3	6
		200		
		33	L4	
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF	50200641	125		7
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF	50200641	0		8
A-RS Kupferfolie-009my 330x490mm	50201012	35	L5	9
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF	50200641	60		10
A-RS Kupferfolie-009my 330x490mm	50201012	9	RS	11

A00 B00 C00

Dicke nach Verpressen

B00:

550 µm

Tol+:

100 µm

Tol-:

100 µm

Dmax:

650 µm

Dmin:

450 µm

C00:

690 µm

Tol+:

100 µm

Tol-:

100 µm

Dmax:

790 µm

Dmin:

590 µm

Gesamtdicke über alles

0 µm

Tol+:

0 µm

Tol-:

0 µm

Dmax:

0 µm

Dmin:

0 µm

Kundenforderung

Dicke (D):

800 µm

Tol+:

100 µm

Tol-:

100 µm

Dmax:

900 µm

Dmin:

700 µm

Messstelle:

(05) über LM und galv.Cu; beidseitig

nominal:

724 µm

Version 1.2.20.19

© Würth Elektronik